

Stati Uniti: Partecipazione collettiva ICE Agenzia alla Fiera PACK EXPO CHICAGO 2024 (3/6 novembre 2024)

Circolare 417 del 17/04/2024 - Internazionalizzazione

ICE-Agenzia, in collaborazione con UCIMA (Unione Costruttori Italiane Macchine Automatiche per il Confezionamento e l'Imballaggio), organizza una partecipazione collettiva delle Aziende italiane alla fiera **PACK EXPO CHICAGO 2024**, in programma a **Chicago, Stati Uniti, dal 3 al 6 novembre 2024**.

PACK EXPO è la più importante fiera nordamericana dedicata ai settori del packaging e del processing e si svolge in autunno con cadenza annuale in sedi alternate. L'edizione di Chicago è ritenuta essere la più importante in termini di partecipazione e qualità delle aziende presenti.

Condizioni di partecipazione

La collettiva italiana organizzata dall'Agenzia ICE si trova in un'area suddivisa in moduli pre-allestiti di 9 mq. per i quali è richiesta una quota di partecipazione di € 4.500 + IVA. Eventuali metri quadri aggiuntivi saranno disponibili a € 500 + IVA.

Le richieste di adesione saranno accolte dal 17 aprile al 3 maggio p.v..

Per partecipare è necessario compilare con firma e timbro aziendale la documentazione di iscrizione riportata nella circolare informativa e inviarla via PEC all'indirizzo industrialeggera@cert.ice.it, inserendo in cc l'indirizzo salvini@ali.legnano.mi.it. Per maggiori dettagli in merito alle condizioni di partecipazione si rimanda alla circolare informativa in allegato.

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221).

Fonte: <https://www.confindustria-am.it/servizi/internazionalizzazione/circolari/stati-uniti-partecipazione-collettiva-ice-agenzia-alla-fiera-pack-expo-chicago-2024-3-6-novembre-2024>